

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2023/118574 A1

(43) Date de la publication internationale
29 juin 2023 (29.06.2023)

(51) Classification internationale des brevets :

H01L 21/02 (2006.01) H03H 3/02 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01) H03H 3/08 (2006.01)
H01L 21/762 (2006.01) H03H 9/02 (2006.01)
H10N 30/073 (2023.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2022/087749

(22) Date de dépôt international :

23 décembre 2022 (23.12.2022)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :

FR2114469 23 décembre 2021 (23.12.2021) FR

(71) Déposant : **SOITEC** [FR/FR] ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR).

(72) Inventeurs : **THIBERT, Sebastien** ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR). **GAUMER, Clement** ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin Des Franques, 38190 Bernin (FR). **CHAR-**

LES-ALFRED, Cedric ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin Des Franques, 38190 Bernin (FR).

(74) Mandataire : **GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB** ; Leopoldstr. 4, 80802 Munich (DE).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

(54) Title: METHOD FOR FABRICATING A DONOR SUBSTRATE

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT DONNEUR

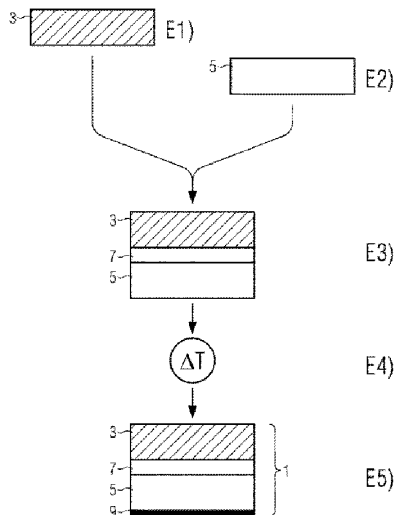


FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for fabricating a donor substrate comprising the steps of A: providing a manipulation substrate, B: providing a target substrate, C: attaching the target substrate to the manipulation substrate, and D: grinding, particularly machine-grinding the target substrate attached to the manipulation substrate in order to form the donor substrate, the method being characterized in that a waiting time of predetermined duration is observed between step C and step D.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un substrat donneur comprenant les étapes de A: la fourniture d'un substrat de manipulation, B : la fourniture d'un substrat cible, C : l'attachement du substrat cible sur le substrat de manipulation et D : la rectification, en particulier par meulage, du substrat cible attaché sur le substrat de manipulation, pour former le substrat donneur, le procédé étant caractérisé en ce qu'un délai d'attente d'une durée prédéterminée est respecté entre l'étape C et l'étape D.

WO 2023/118574 A1

[Suite sur la page suivante]

MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))